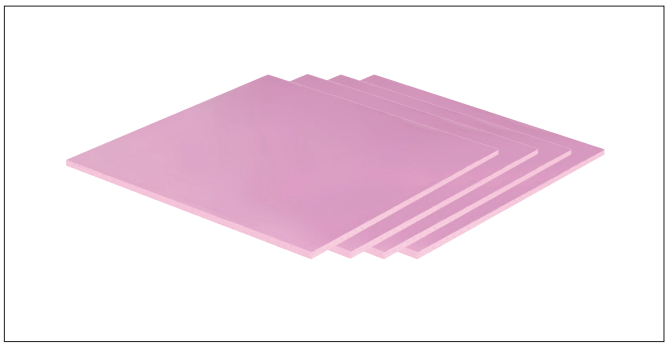
Thermal Pad APT2012

Hochleistungs-Wärmeleitpad



- Nicht leitfähig
- Nicht kapazitiv
- Sehr einfache Anwendung
- Schutz für empfindliche Prozessor-Chips
- Nicht klebend

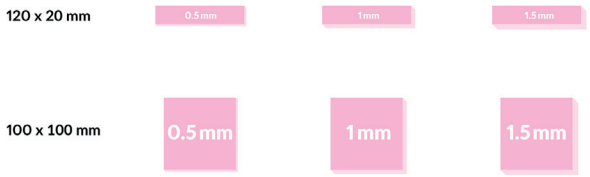
Das ARCTIC Thermal Pad bietet eine effiziente thermische Schnittstelle zwischen Kühlkörper und elektronischen Geräten, wenn unebene Oberflächen, Luftspalte und raue Oberflächenstrukturen vorhanden sind. Das auf Silikon basierenden Material übertrifft generische Pads, ist flexibel sowie anpassungsfähig und arbeitet somit auch bei niedrigem Druck.

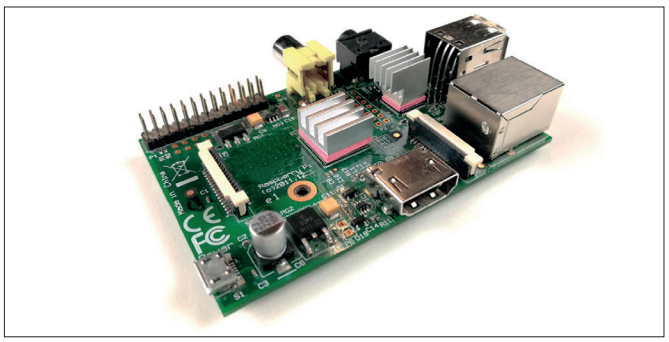
Technische Daten

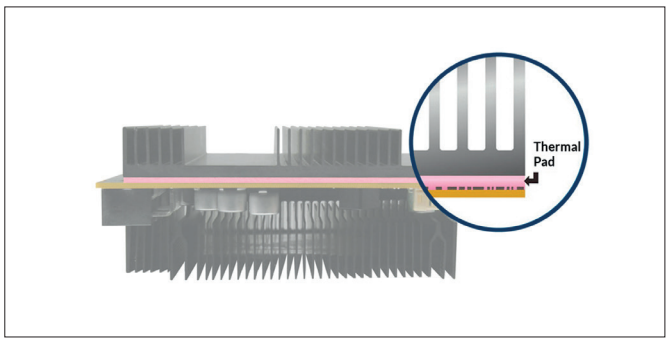
Allgemeine Eigenschaften	
Farbe	Pink
Härtegrad: 0.5/1 mm Stärke	35 Shore OO
Härtegrad: 1 mm Stärke	20 Shore OO
Dauergebrauchstemperatur	-40~150 °C
Spezifisches Gewicht	2,3 g/cc
Wärmeleitfähigkeit	1,2 W/(m K)

Elektrische Eigenschaften	
Dielektrizitätskonstante @1MHz	3.9
Durchgangswiderstand	1 X 10^12 Ω-cm
Entflammbarkeitsklassifizierung	UL 94 V-0

Abmessungen	SKU
120 x 120 mm – 0.5 mm	ACTPD00023A
120 x 20 mm – 1 mm	ACTPD00024A
100 x 100 mm – 0.5 mm	ACTPD00020A
100 x 100 mm – 1 mm	ACTPD00021A
100 x 100 mm – 1.5 mm	ACTPD00022A







Verwendung der Pads

Die Pads lassen sich problemlos auf ihre gewünschte Form und Größe zuschneiden und sich so beispielsweise auf RAM-Kühlkörpern und Einplatinencomputern verwenden um eine angemessene Temperaturübertragung sicher zu stellen.

Überbrückung von Unebenheiten

Dank der geringen Härte und guter Komprimierungseigenschaften wirkt das Thermal Pad als perfekter Gap Filler und überbrückt problemlos unebene Oberflächen und Luftspalten.